

No.	指令/EC決定	和訳	英文
1.	2002/95/EC	水銀が一本当たり5mgを超えないコンパクト蛍光灯ランプ	Mercury in compact fluorescent lamps not exceeding 5 mg per lamp
2a.	2002/95/EC	一般用直管形蛍光灯ランプ(ハロリン酸塩ランプ)内の10mgを超えない水銀	Mercury in straight fluorescent lamps for general purposes not exceeding 10 mg in halophosphate lamps.
2b.	2002/95/EC	一般用直管形蛍光灯ランプ(通常寿命の三リン酸塩ランプ)内の5mgを超えない水銀	Mercury in straight fluorescent lamps for general purposes not exceeding 5 mg in triphosphate lamps with a normal lifetime.
2c.	2002/95/EC	一般用直管形蛍光灯ランプ(長寿命の三リン酸塩ランプ)内の8mgを超えない水銀	Mercury in straight fluorescent lamps for general purposes not exceeding 8 mg in triphosphate lamps with long lifetime.
3.	2002/95/EC	特殊用途直管形蛍光灯ランプ中の水銀	Mercury in straight fluorescent lamps for special purposes
4.	2002/95/EC	その他のランプに含まれる水銀	Mercury in other lamps not specifically mentioned in this Annex
5.	2002/95/EC	CRT、電子部品、蛍光管のガラスに含まれる鉛	Lead in glass of cathode ray tubes, electronic components and fluorescent
6a.	2002/95/EC	鋼鉄合金に含まれる鉛で、重量比で0.35%を超えないもの	Lead as an alloying element in steel containing up to 0.35 % lead by weight
6b.	2002/95/EC	アルミニウム合金に含まれる鉛で、重量比で0.4%を超えないもの	Lead as an alloying element in aluminum containing up to 0.4 % lead by weight
6c.	2002/95/EC	銅合金に含まれる鉛であって、重量比で4%を越えないもの	Lead as an alloying element in copper containing up to 4 % lead by weight
7a.	2002/95/EC	高融点はんだ内の鉛(重量比で鉛85%以上を含む鉛合金)	Lead in high melting temperature type solders (i.e. lead based solder alloys containing 85 % by weight or more lead)
7b.	2002/95/EC	サーバー、データストレージ、およびデータストレージアレイシステム、通信システムのネットワーク管理はもちろん、スイッチング、信号処理、伝送などの機器内のはんだに含まれる鉛	Lead in solders for servers, storage and storage array systems, network infrastructure equipment for switching, signaling, transmission as well as network management for telecommunications
7c.	2002/95/EC	電子セラミック部品(例えば圧電素子)に含まれる鉛	Lead in electronic ceramic parts (e.g. piezoelectronic devices)
8.	2002/95/EC	電気的接点やめっきに含まれるカドミウム及びその化合物(EU指令<76/769/EEC>の修正指令<91/338/EEC>で禁止されている用途を除く)	Cadmium and its compounds in electrical contacts and cadmium plating except for applications banned under Directive 91/338/EEC amending Directive 76/769/EEC relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations
9.	2002/95/EC	吸収型冷蔵庫の炭素鋼冷却システムの耐蝕材として用いられる六価クロム	Hexavalent chromium as an anti-corrosion of the carbon steel cooling system in absorption refrigerators.
9a.	2005/717/EC	重合用途のデカ臭化ジフェニルエーテル(Deca BDE)	DecaBDE in polymeric applications
9b.	2005/717/EC	鉛青銅製ベアリングシェル/軸受けに含まれる鉛	Lead in lead-bronze bearing shells and bushes
11.	2005/747/EC	コンプライアント-ピン-コネクタシステムに含まれる鉛	Lead used in compliant pin connector systems
12.	2005/747/EC	熱伝導モジュールCリングのコーティング材に含まれる鉛	Lead as a coating material for a thermal conduction module c-ring.
13a.	2005/747/EC	光学、フィルターガラスに含まれる鉛	Lead in optical and filter glass
13b.	2005/747/EC	光学、フィルターガラスに含まれるカドミウム	Cadmium in optical and filter glass
14.	2005/747/EC	マイクロプロセッサのパッケージとピンを接続するための合金はんだに含まれる鉛で重量比80%以上、85%未満の含有率となるもの	Lead in solders consisting of more than two elements for the connection between the pins and the package of microprocessors with a lead content of more than 80% and less than 85% by weight
15.	2005/747/EC	ICフリップチップ内部のダイとキャリアとの間を電氣的に接続するためのはんだに含まれる鉛	Lead in solders to complete a viable electrical connection between semiconductor die and carrier within integrated circuit Flip Chip packages
16.	2006/310/EC	ケイ酸塩がコーティングされたバルブを用いる直線状白熱電球の鉛	Lead in linear incandescent lamps with silicate coated tubes.

17.	2006/310/EC	業務用複写用途に供する高輝度放電(HID)ランプ内の放射媒体としてのハロゲン化鉛	Lead halide as radiant agent in High Intensity Discharge (HID) lamps used for professional reprography applications.
18.	2006/310/EC	BSP(BaSi2O5:Pb)等の蛍光体を含む日焼け用ランプとして、およびSMS((Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb)等の蛍光体を含む、ジアゾ印刷複写、リソグラフィ、捕虫器、光化学、硬化処理用の専用ランプとして使用される放電ランプの蛍光体の付活剤としての鉛(重量比1%以下の鉛)	Lead as activator in the fluorescent powder (1 % lead by weight or less) of discharge lamps when used as sun tanning lamps containing phosphors such as BSP (BaSi2O5:Pb) as well as when used as specialty lamps for diazo-printing reprography, lithography, insect traps, photochemical and curing processes containing phosphors such as SMS ((Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb).
19.	2006/310/EC	非常にコンパクトな省エネルギーランプ(ESL)における、主アマルガムとしての特定の組成物PbBiSn-HgおよびPbInSn-Hg、ならびに補助アマルガムとしてのPbSn-Hgの鉛	Lead with PbBiSn-Hg and PbInSn-Hg in specific compositions as main amalgam and with PbSn-Hg as auxiliary amalgam in very compact Energy Saving Lamps (ESL).
20.	2006/310/EC	液晶ディスプレイ(LCD)に使用される平面蛍光ランプの前面および後面基板を接合するために使用されるガラスの中の酸化鉛	Lead oxide in glass used for bonding front and rear substrates of flat fluorescent lamps used for Liquid Crystal Displays (LCD).
21.	2006/691/EC	ホウケイ酸ガラスへのエナメル塗布用印刷インクに含有される鉛およびカドミウム	Lead and cadmium in printing inks for the application of enamels on borosilicate glass.
22.	2006/691/EC	光ファイバー通信システムに使用されるRIGファラデー回転子に不純物として含まれるPb	Lead as impurity in RIG (rare earth iron garnet) Faraday rotators used for fiber optic communications systems.
23.	2006/691/EC	0.65nmピッチ以下のNiFeリードフレームコネクタ以外の微細ピッチコンポーネント用仕上剤の鉛。0.65nmピッチ以下で銅フレームコネクタ以外の微細ピッチコンポーネント用仕上剤の鉛	Lead in finishes of fine pitch components other than connectors with a pitch of 0.65 mm or less with NiFe lead frames and lead in finishes of fine pitch components other than connectors with a pitch of 0.65 mm or less with copper lead frames.
24.	2006/691/EC	機械加工通し穴付円盤状及び平面アレーセラミック多層コンデンサのはんだ付けに使用するはんだに含まれる鉛	Lead in solders for the soldering to machined through hole discoidal and planar array ceramic multilayer capacitors.
25.	2006/691/EC	構造体として使用するPDPおよびSEDに含まれる酸化鉛。特に前面および背面ガラス誘電体層、バス電極、ブラックストライプ、アドレス電極、バリアリブ、シールフリット、フリットリングおよびプリントペーストに含まれる酸化鉛	Lead oxide in plasma display panels (PDP) and surface conduction electron emitter displays (SED) used in structural elements; notably in the front and rear glass dielectric layer, the bus electrode, the black stripe, the address electrode, the barrier ribs, the seal frit and frit ring as well as in print pastes.
26.	2006/691/EC	ブラックライトブルー (BLB) ランプのガラス筐体に含まれる酸化鉛	Lead oxide in the glass envelope of Black Light Blue (BLB) lamps.
27.	2006/691/EC	125dB SPL以上の音響パワーレベルで数時間動作する高出力スピーカー用変換器のはんだに使用する鉛合金	Lead alloys as solder for transducers used in high-powered (designated to operate for several hours at acoustic power levels of 125 dB SPL and above) loudspeakers.'
28.	2006/692/EC	無塗装金属板およびファスナーの防食用途と2002/96/ECのカテゴリ3に属する設備 (ITおよび通信設備) の電磁気インターフェースシールドに含有する6価クロム。この除外は2007年7月1日まで。	Hexavalent chromium in corrosion preventive coatings of unpainted metal sheetings and fasteners used for corrosion protection and Electromagnetic Interference Shielding in equipment falling under category three of Directive 2002/96/EC (IT and telecommunications equipment). Exemption granted until 1 July 2007.'
29.	2006/690/EC	理事会指令69/493/EECの付属書 (カテゴリ1~4) で定義されるクリスタルガラスに含有する鉛	Lead bound in crystal glass as defined in Annex I (Categories 1, 2, 3 and 4) of Council Directive 69/493/EEC (*).